

证券代码：600460

股票简称：士兰微

编号：临 2018-010

## 杭州士兰微电子股份有限公司

### 投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为加快公司在半导体产业链的布局，并落实与厦门市海沧区人民政府签署的《战略合作框架协议》，杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）与厦门半导体投资集团有限公司（以下简称“投资双方”）于 2017 年 12 月 18 日在中国厦门共同签署了《关于 12 吋集成电路制造生产线项目之投资合作协议》和《关于化合物半导体项目之投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”）。公司于 2018 年 1 月 11 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与厦门半导体投资集团有限公司签署〈关于 12 吋集成电路制造生产线项目之投资合作协议〉的议案》和《关于与厦门半导体投资集团有限公司签署〈关于化合物半导体项目之投资合作协议〉的议案》。（详见公司于 2017 年 12 月 19 日和 2018 年 1 月 12 日发布的编号为临 2017-066、临 2017-067、临 2017-068 和临 2018-001 号公告）。

根据上述《投资合作协议》，投资双方已于近日在厦门市分别注册成立了项目公司：

一、根据《关于 12 吋集成电路制造生产线项目之投资合作协议》，投资双方注册成立了厦门士兰集科微电子有限公司，并已办理完成工商注册登记，取得了厦门市市场监督管理局颁发的营业执照，基本情况如下：

名称：厦门士兰集科微电子有限公司

类型：法人商事主体（其他有限责任公司）

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路 45 号 4 楼 03 单元 F0060

法定代表人：王汇联

注册资本：贰拾亿元整

成立日期：2018 年 2 月 1 日

营业期限：2018 年 2 月 1 日至 2068 年 1 月 31 日

经营范围：集成电路制造；半导体分立器件制造；电子元件及组件制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）。

二、根据《关于化合物半导体项目之投资合作协议》，投资双方注册成立了厦门士兰明镓化合物半导体有限公司，并已办理完成工商注册登记，取得了厦门市市场监督管理局颁发的营业执照，基本情况如下：

名称：厦门士兰明镓化合物半导体有限公司

类型：法人商事主体（其他有限责任公司）

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路 45 号 4 楼 03 单元 F0055

法定代表人：王汇联

注册资本：捌亿元整

成立日期：2018 年 2 月 1 日

营业期限：2018 年 2 月 1 日至 2068 年 1 月 31 日

经营范围：集成电路制造；光电子器件及其他电子器件制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日